

2021年9月15日

一般社団法人 電子情報技術産業協会
事業推進部

JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会 2021

新型コロナウイルス感染症の流行により、ニューノーマル時代に様々な対応が求められる今、今後の経済や企業の取り組みも大きく変わろうとしています。

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に、1997年からはんだ鉛フリー化をはじめ、環境に配慮した実装技術開発活動に取り組み、活動成果は毎年「活動報告会」を開催して広く普及を図って参りました。変革期を迎える今年も、先端的な実装技術の検討結果をご紹介させて頂くべく『JEITA 実装技術標準化 活動報告会』（Webによるリモート報告会）を開催することとしました。

今回は、産業全体に関わる動向のご紹介として、最新の標準化政策について経済産業省からご講演を頂き、その後、経済産業省プロジェクトをはじめ、JEITA規格・JIS規格の制定等、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜り、各社の事業にお役立て頂けますよう、宜しく願い申し上げます。

日時：2021年10月12日(火) 13:30~16:35

■ 申込サイト：<https://www.jeita.or.jp/form/custom/58/form>

■ 主催：実装技術標準化専門委員会

■ 開催形態：オンライン会議システム（WebEX）による報告会

■ 参加費（税込）：

①無料（PDF資料を含む）

②3,000円（PDF資料、及び冊子資料集（PDFと内容は同じです）を含む）

冊子資料集もご希望の方は②をお申し込み下さい。報告会終了後に郵送致します。

（※請求書は後日、電子データにて発行させていただきます。）

■ 申込方法：上記申込サイトからお申し込み下さい。

資料及びオンライン会議（WebEX）参加案内は、開催2日前を目途にご連絡致します。

■ 申込期限：2021年10月7日(木)

■ 事務局：一般社団法人 電子情報技術産業協会

事業推進部（布川・澤田）

E-mail k-fukawa@jeita.or.jp; naomi.sawada@jeita.or.jp

■ プログラム

第 1 部 : 来賓及び基調講演

〔司会 : 反保 昌博 JEITA 実装技術標準化専門委員会 副委員長 (株)村田製作所〕

【主催者挨拶】

13:30-13:35 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会委員長
東芝デバイス&ストレージ(株)

【来賓挨拶】

13:35-13:40 二瓶 望美氏 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 電子デバイス係長

【基調講演】

13:40-14:10 「最近の標準化政策について」
柳澤 智也 氏 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課長

第 2 部 : METI プロジェクト

〔司会 : 諏訪 正樹 JEITA 実装技術標準化専門委員会 幹事 KOA(株) 〕

14:10-14:25 「複合材料電子回路基板の放熱設計手法に関する国際標準化プロジェクト」につ
いて

畠山 友行 複合材料電子回路基板の放熱設計手法に関する国際標準化研究
委員会副委員長 富山県立大学

14:25-14:50 「温度測定方法 WG」の活動について
福江 高志 温度測定 WG 主査 金沢工業大学

14:50-15:00 「熱伝導率測定方法 WG」の活動について
真田 和昭 熱伝導率測定方法 WG 主査 富山県立大学

15:00-15:20 「三次元電子モジュールに関する国際標準化」
加藤 義尚 部品内蔵技術標準化研究委員会委員長 福岡大学

15:20-15:40 「電力半導体デバイス接合部の国際標準化」の後継活動について
高橋 浩之 フォローアップ委員会副委員長 (株)東芝

----- (休憩 20 分) -----

第 3 部 : JEITA 規格・技術

〔司会 : 山田 浩 JEITA 実装技術標準化専門委員会 幹事 (株)東芝〕

16:00-16:10 「ウイスカ及び実装材料研究会活動の紹介」
坂本 一三 ウイスカ及び実装材料研究会 主査 S.C.L

16:10-16:30 「低温実装ウイスカについて」
斎藤 彰 ウイスカ及び実装材料研究会 副主査 (株)村田製作所

【おわりに】

16:30-16:35 山本 克己氏 経済産業省 産業技術環境局国際電気標準課 課長補佐

※ プログラムは変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。